

2019 ECTC での海外論文発表



目で見ると
海外論文発表

張 政 (ZHANG ZHENG) *

2019 ECTC in Las Vegas

Key Words : Ag paste sintering, Ni/Au surface finish, Preheating treatment, Metallization structure

<参加会議名> 2019 ECTC (IEEE 69th Electronic Components and Technology Conference)

<開催場所> The Cosmopolitan of Las Vegas

<渡航期間> 2019年5月27～31日

<発表タイトル>

Improving thermal aging reliability of Ag paste sintering on Ni/Au surface finish by modifying the surface structure

私は2019年5月28～31日の期間にアメリカ・ラスベガスで開催された国際会議2019 ECTC (IEEE 69th Electronic Components and Technology Conference)に参加し、自身の博士論文研究に関連する成果について、口頭発表を行いました。本会議は、パッケージング、コンポーネント、およびマイクロエレクトロニクスに関する研究に焦点を当てており、最先端な技術の交流を通じて、国際間における研究協力の促進を目的としています。ECTCは長い歴史を持ち、今回は69回目の開催となります。私自身にとっては初めての参加で、大変貴重な経験になりました。

会場には、世界各地から数多くの研究者が招待されており、様々な材料や技術を扱った研究成果を見聞することができました。発表セッション以外にも、専門家による専門能力開発コースも開催されており、

非常に有意義な時間を過ごすことができました。初めてのこの規模の国際学会で、多岐に渡る演題や最新の知見など、各国の研究者の熱意に驚かされました。今回、私はAu/Niメッキの表面に銀ペーストの接合プロセスに関する研究を発表しました。発表内容について質問やご意見をいただくこともでき、とても勉強になりました。このような国際学会発表において評価を頂けたことはうれしい限りであり、今後の研究において今回の経験を活かしていければと思います。また、そのあとのバンケットやイベント通して他国の若手研究者と繋がりを持ち、自分の新たな目標を見つけることができました。

最後に、本会議への参加にあたり、御支援を賜りました生産技術振興協会に心より感謝申し上げます。



写真1 発表の様子と会場



* ZHANG ZHENG

1991年6月生まれ
現在、大阪大学工学部機能知能創成専攻
博士後期課程 (D2)
菅沼研究室
E-mail :
zhangzheng@eco.sanken.osaka-u.ac.jp